東証IRフェスタ 2011　会社説明会

東京エレクトロン デバイス㈱

2011年3月11日

代表取締役社長　栗木 康幸

東京エレクトロン デバイス株式会社

本日のご説明内容

1. 会社概要
2. 半導体商社の動向
3. 当社ビジネス
4. 足元の業況及び業績見込み
5. 成長戦略（3ヶ年計画）
6. 株主還元

1. 会　社　概　要

当 社 概 要

◆ 設　立　：1986年3月3日

◆ 事業内容：半導体、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾈｯﾄﾜｰｸ機器等の専門商社

◆ 売 上 高　：2010年3月期 851億円
2011年3月期 930億円(予定)

◆ 本　社　：横浜市神奈川区金港町1番地4横浜ｲｰｽﾄｽｸｴｱ

◆ 従 業 員　：連結880名（2010年12月31日）

◆ 関連会社：東京エレクトロン デバイス上海
東京エレクトロン デバイス香港
東京エレクトロン デバイスシンガポール
パネトロン株式会社

国 内 営 業 拠 点

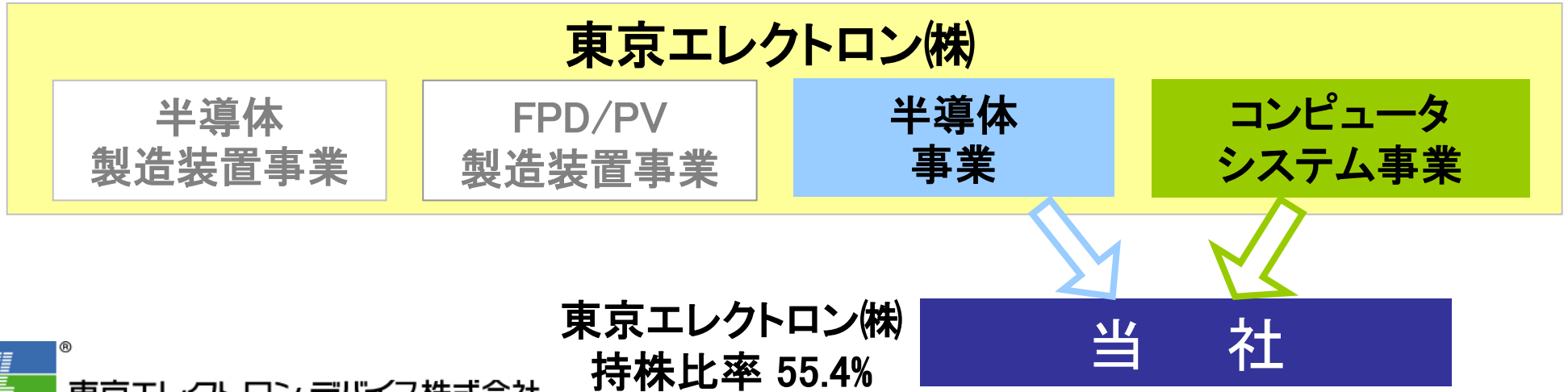
◆ 全国 21拠点

2010年 4月　姫路営業所、
　　広島営業所開設
2010年10月　郡山オフィス開設

当 社 沿 革

◆40年超の歴史と経験を有する専門商社

- 1965年　東京エレクトロン㈱の半導体事業部門でビジネスを開始
- 1986年　当社の前身であるテル管理サービス㈱を設立（登記上の設立日）
- 1990年　東京エレクトロンデバイス㈱に社名変更し半導体ビジネスを開始
- 1998年　東京エレクトロン㈱の半導体事業の承継完了
- 2003年　東証2部 上場（3月7日）
- 2006年　コンピュータシステム事業を承継
- 2010年　東証1部 上場（12月24日）



2. 半導体商社の動向

上場半導体商社(同業他社)

【日系メーカー系(日本の半導体メーカーの商品を主に取り扱う商社)】

㈱エクセル、㈱カナデン、佐鳥電機㈱、三信電気㈱、新光商事㈱、
都築電産㈱、㈱立花エレテック、㈱バイテック、㈱UKCホールディングス、
㈱リョーサン、菱電商事㈱、菱洋エレクトロ㈱ 、㈱ルネサスイーストン

【海外メーカー系(海外の半導体メーカーの商品を主に取り扱う商社)】

㈱アムスク、インターニックス㈱、加賀電子㈱、黒田電気㈱、
㈱トーメンエレクトロニクス、㈱トーメンデバイス、伯東㈱、
㈱パルテック、富士エレクトロニクス㈱、㈱マクニカ、丸文㈱、
当社

注) 上記会社の選定は、当社の推定により行っております。
社名は、五十音順に記載しております。

半導体商社の動向

◆ 従来型の商社機能を強化

⇒商権獲得、物流業務の強化

◆ 海外展開を強化

⇒海外拠点の拡充、海外半導体商社と提携

◆ 技術商社を志向

⇒技術サポートが必要な高付加価値商品の拡充、
お客様の製品設計部へ提案営業（デザインイン）、
自社ブランド商品（メーカー機能）

3. 当 社 ビ ジ ネ ス

① 半導体事業

② 開発ビジネス

③ コンピュータシステム事業

① 半導体事業

ビジネス形態

【 仕 入 先 】

半導体
メーカー

仕入

【 当 社 】

商　社

販売

【主なお客様 】

電子機器
メーカー

【特徴】

◆ 外国系有力メーカーを中心に約45社

◆ 最先端商品をﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

【特徴】

◆ 高付加価値半導体を技術ｻﾎﾟｰﾄとともに提供する技術商社

【特徴】

◆ ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ、PC、携帯電話、医療機器など幅広分野に満遍なく販売

仕 入 先

◆ 外国系有力メーカー中心に約45社

◆ 最先端商品をマーケティング

【外国系35社】

ザイリンクス XILINX	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙﾛｼﾞｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ（PLD）半導体で50% 以上のｼｪｱを占めるNO.1企業
ＴＩ TEXAS INSTRUMENTS	半導体ﾒｰｶｰ売上高ﾗﾝｷﾝｸﾞ世界4位 ﾃﾞｼﾀﾙｼｸﾞﾅﾙﾌﾟﾛｾｯｻ（DSP）でNO.1企業
リニアテクノロジー LINEAR TECHNOLOGY	高機能ｱﾅﾛｸﾞIC分野で世界を代表する企業
フリースケール freescale semiconductor	ﾓﾄﾛｰﾗ社から分離独立。CPUの代表的企業

【国内10社】

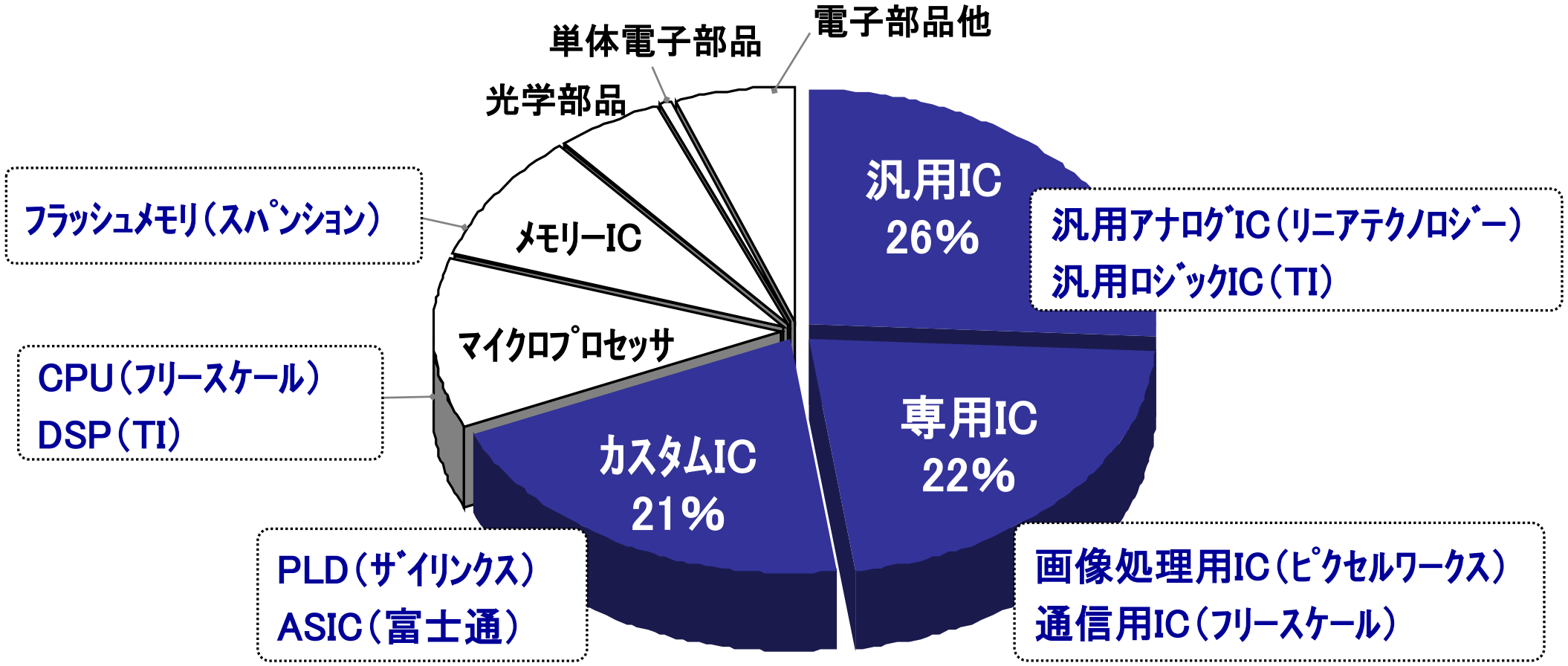
富士通、コーセルなど

注）社名は敬称を省略し、略称で記載しております。

品目別売上構成

- 高付加価値半導体を中心とした商品構成
- 最先端商品を技術サポートとともに提供

＜2011年3月期中間 売上高374億円＞

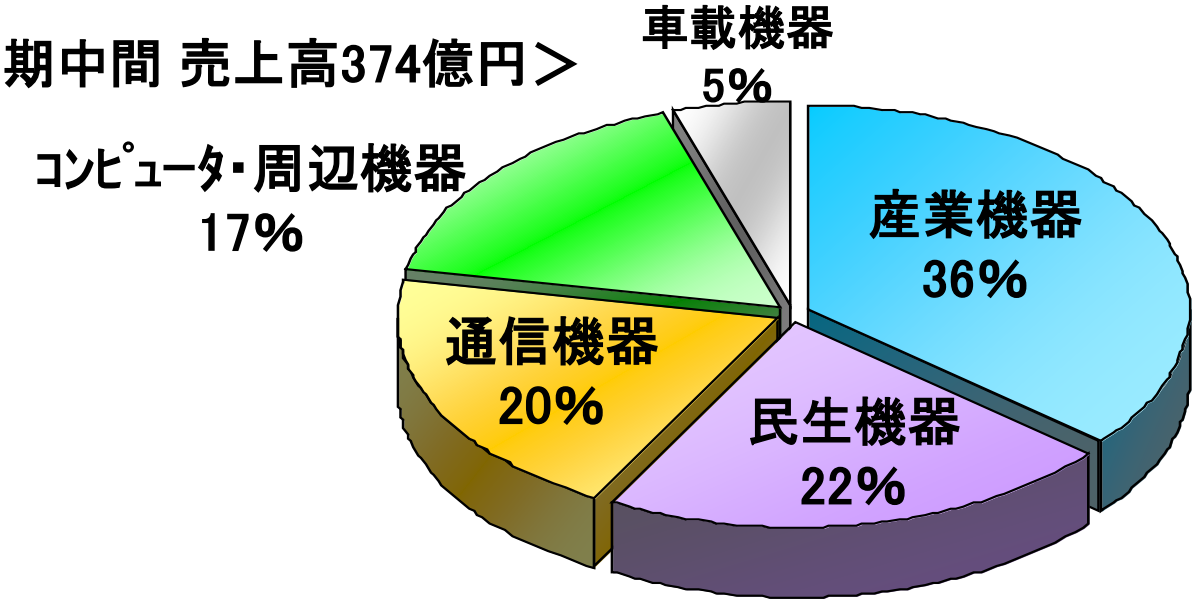


注）社名は敬称を省略し、略称で記載しております。

最 製 品 別 売 上 構 成

◆ 最終製品は幅広い分野に満遍なく販売

＜2011年3月期中間 売上高374億円＞



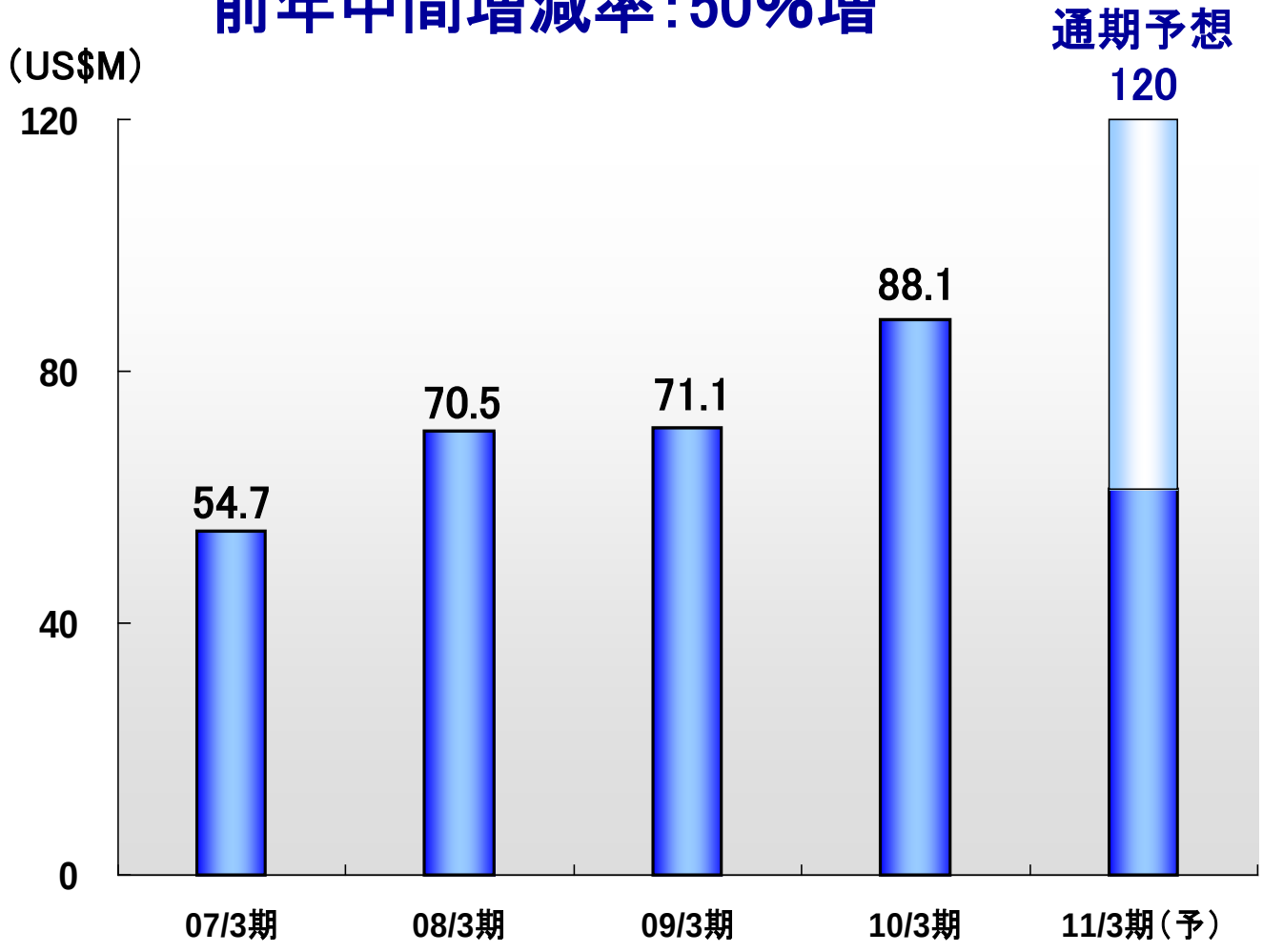
分　野	主な最終製品	主なお客様
産業機器	医療機器、金融端末、半導体製造装置、FA機器	沖電気、東芝、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ他
民生機器	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、薄型TV 、AV機器	ｿﾆｰ、東芝、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ、日立他
通信機器	携帯電話、ﾙｰﾀｰ、伝送装置、携帯電話基地局	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ、日立、富士通他
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･周辺機器	複合ﾌﾟﾘﾝﾀ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、PC及び付属機器	NEC、ｾﾞﾛｯｸｽ、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ他
車載機器	ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ、ｶｰｵｰﾃﾞｨｵ	ｱｲｼﾝ、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ他

注）社名は、敬称を省略し、略称を使用し、五十音順で記載させていただいております。

海外ビジネス

【 海外連結子会社 売上高推移 】

中間売上高： 61百万ドル
前年中間増減率：50%増



【 営 業 拠 点 】

2010年12月：マレーシアに拠点開設

② 開発ビジネス

inevium

開発ビジネス

◆ メーカー機能への取り組み

自社ブランド商品

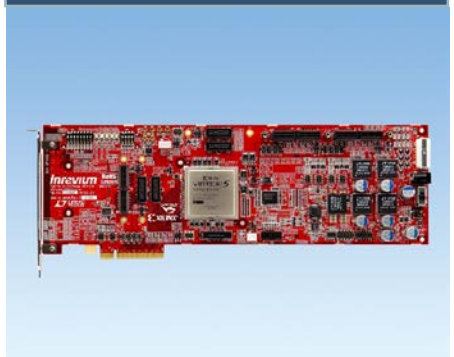
◆ 80種類以上ラインアップ、セキュリティ商品を拡充

映像機器用LSI

メモリコントローラ用LSI

PLD用LSI

PLD評価ボード

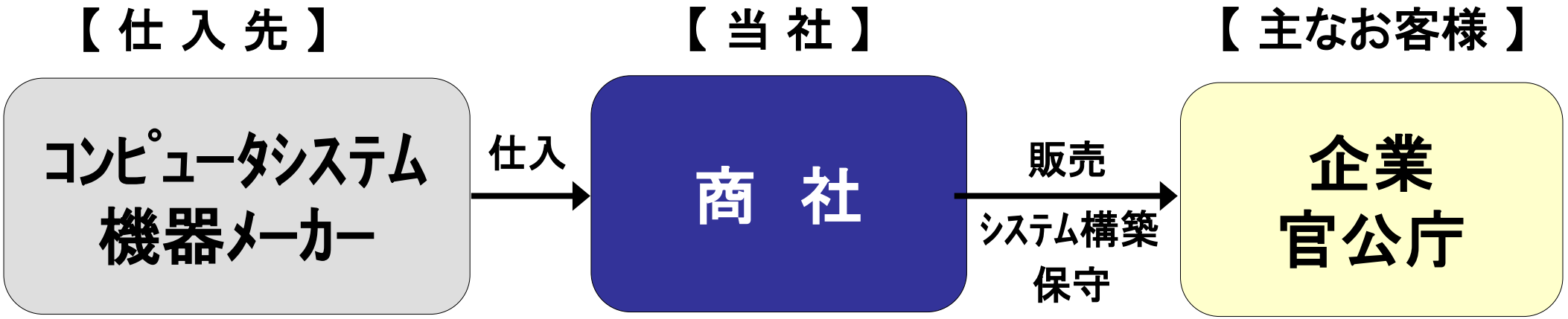


信号処理ボード

3次元計測ボード

③ コンピュータシステム事業

ビジネス形態



【特徴】

◆ ユニークで差別化可能な最先端技術を探し出し国内に投入
ネットワーク関連機器、
ストレージ関連機器、
ソフトウェアなど

【特徴】

◆ 技術的に難しい複合システムを提供

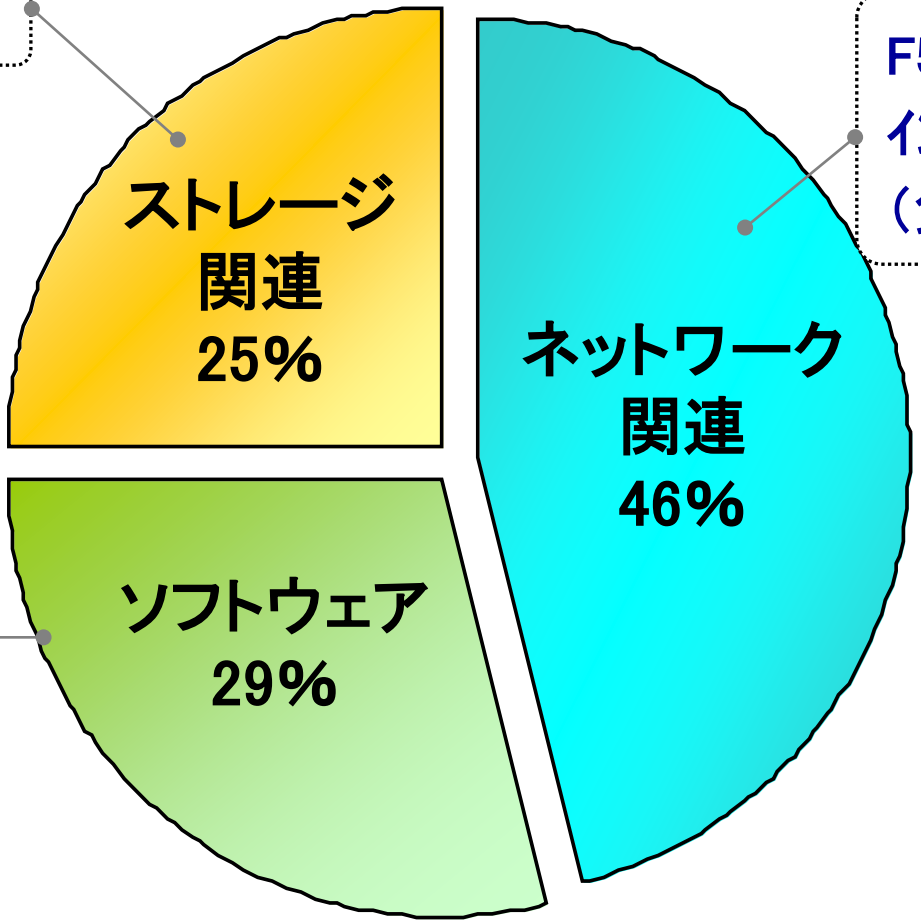
【特徴】

◆ ネットビジネス企業、システム構築企業、企業・官公庁のコンピュータシステム担当部署へ販売

品 目 別 売 上 構 成

＜2011年3月期中間 売上高80 億円＞

ブロケード社
SANスイッチ



F5ネットワークス社
インターネット接続機器
（負荷分散、セキュリティ用）

マイクロソフト社
企業向け産業機器に
組み込まれるソフトウェア

東京エレクトロン デバイス株式会社

注）社名は敬称を省略し、略称で記載しております。

仕 入 先

F5ネットワークス社	ADC（アプリケーションデリバリーコントローラ）市場でのリーダー企業 日本シェア40% 国内3,000社を超える企業に導入
マイクロソフト社 Microsoft	世界標準と呼ばれるWindowsなどパソコンOS市場で世界NO.1企業。 パソコン以外の機器に組み込まれるOS市場でも高シェアを誇る
ブロケード社	ストレージエリアネットワーク（SAN）を構成するファイバーチャネル・スイッチ製品のリーダー企業 国内シェア80%以上

注）社名は敬称を省略し、略称で記載しております。

4. 足元の業況及び業績見込み

当社を取りまく事業環境

【 半導体事業 】

- 上期： 産業機器の回復顕著
  第1四半期好調、第2四半期一服感
- 下期： 一部用途には減速懸念あるが、
  足元の状況は総じて底堅く、堅調持続を想定

【 コンピュータシステム事業 】

- 上期： 企業のIT投資は慎重
  製品販売は回復途上だが想定どおり
  保守は堅調
- 下期： 下期偏重の傾向あり、回復を想定

今期(2011年3月期)業績予想

◆ 9月24日　連結業績を上方修正

(単位:百万円)

	2010年3月期 前期実績 (A)	2011年3月期　今期予想			
		年初発表 2010.4.28	修正発表(B) 2010.9.24	増減額 (B)−(A)	増減率 (%)
売上高	85,145	91,000	93,000	7,854	9.2
営業利益	2,079	2,690	2,870	790	38.0
経常利益	2,117	2,600	2,900	782	37.0
当期純利益	1,166	1,640	1,910	743	63.8

セグメント別 連結売上高予想

（単位：百万円）

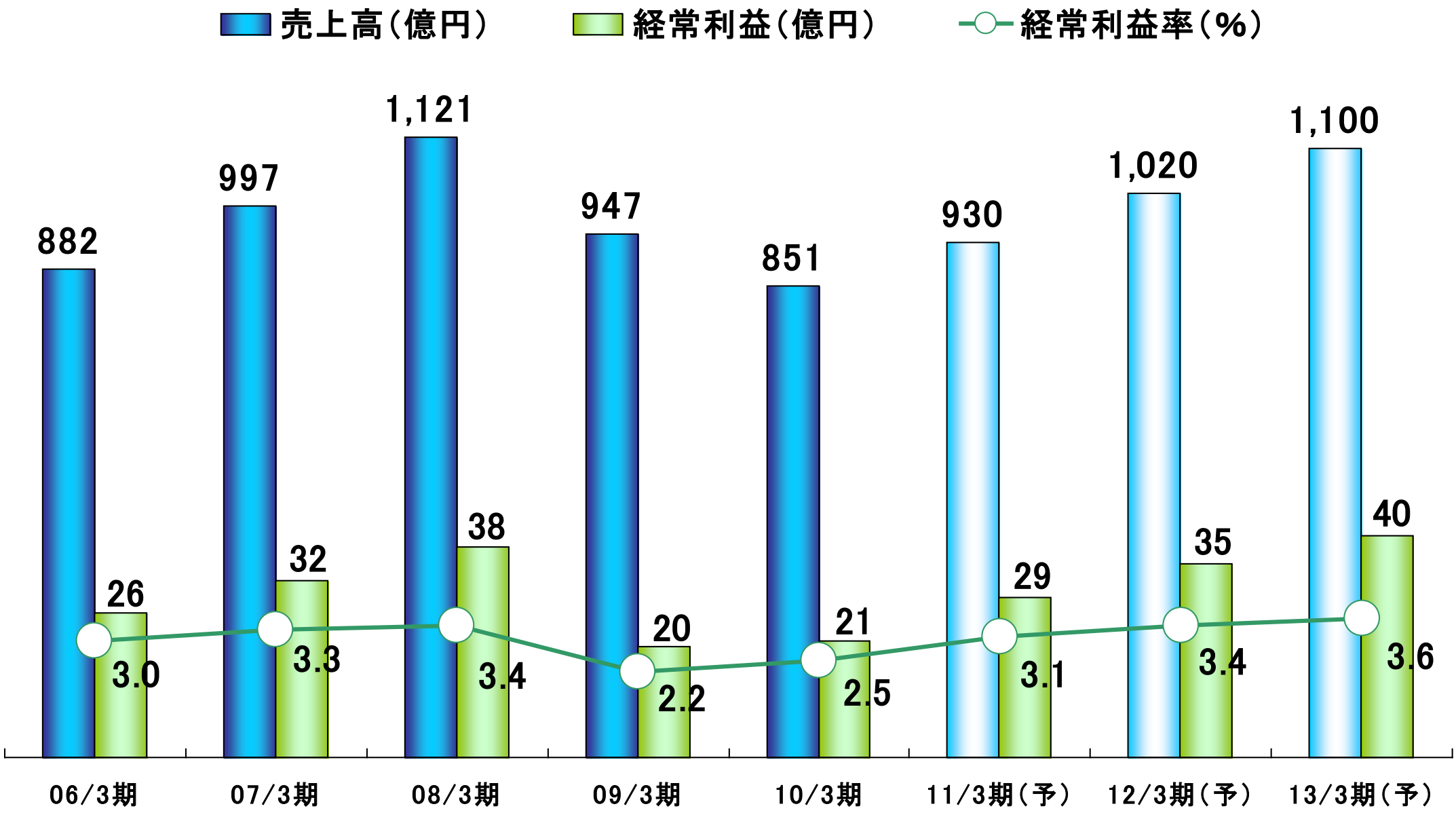
セグメント	中間 実績	下期 予想	通期 予想	対前年通期	
				増減額	増減率 （%）
半導体事業	37,475	37,525	75,000	7,560	11.2
コンピュータ システム事業	8,059	9,941	18,000	293	1.7
合　計	45,535	47,465	93,000	7,854	9.2

5. 成 長 戦 略
（2010年7月　3ヶ年計画を発表）

【3ヶ年計画　施策】

1. 半導体事業（国内展開）
2. 半導体事業（海外展開）
3. 開発ビジネス
4. コンピュータシステム事業
5. 新規事業

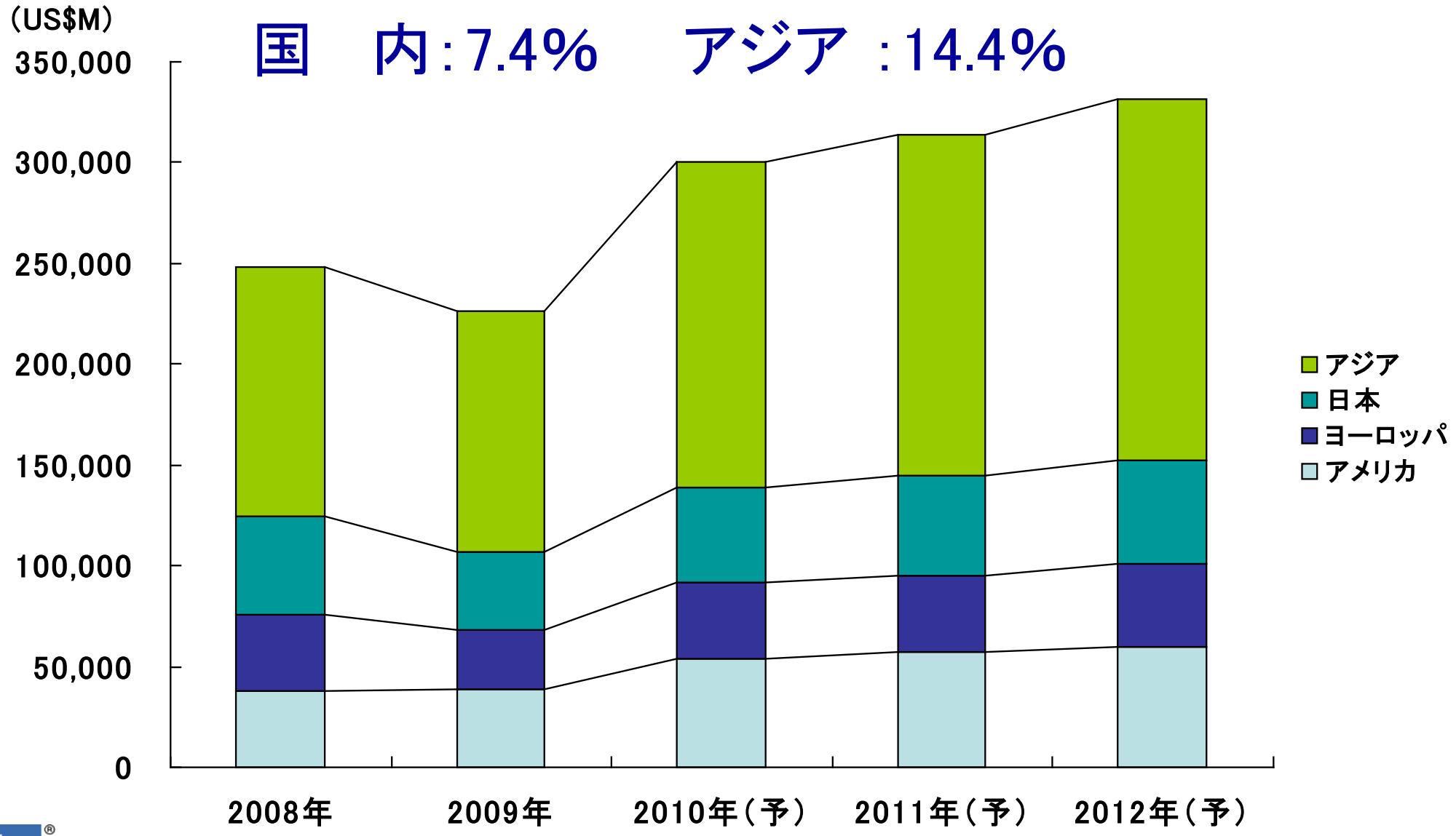
業績推移及び3ヶ年計画



半導体市場予測

平均成長率(2009年～2012年)

国　内:7.4%　　アジア :14.4%



出典)WSTS　2010年秋季半導体市場予測

1. 半導体事業(国内展開)

安定成長の源泉(当社ビジネスの根幹)

- 新規顧客獲得
  - ① 拠点拡充による地域密着営業の一層推進
  - ② 産業機器分野(医療、環境など)に注力
- 商権拡大
  - ① 技術サポートの充実により既存顧客を深耕

目標:半導体市場予測プラスαの成長

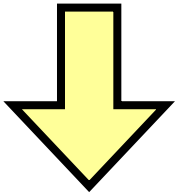
2. 半導体事業(海外展開)

売上拡大の源泉

◆ 有望マーケットであるアジア地域での拡販

① 営業拠点の拡充

② 現地企業への営業強化



目標:半導体事業売上高の20%

利益成長の源泉

- 設計受託業務、OEM販売の推進
  - ① 量産供給及び品質体制の強化
  - ② トップセールスによる顧客拡大
- 自社ブランド商品の拡販
  - ① セキュリティ関連向け商品群の拡充
  - ② アジア地域への販売推進

↓

目標：売上高80億円

利益成長の源泉

- お客様に密着した提案営業を強化
  - ① 製品別営業からお客様別営業に組織改編
  - ② 全国21箇所の営業拠点を活用
- 需要が高まるﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ向けﾋﾞｼﾞﾈｽに注力
  - ① ｼｽﾃﾑ構築、製品販売、保守のﾄｰﾀﾙ提案

目標：コンピュータシステム事業で経常利益率10%

トータル提案営業の強化

◆ 営業体制を改編、直販体制を強化

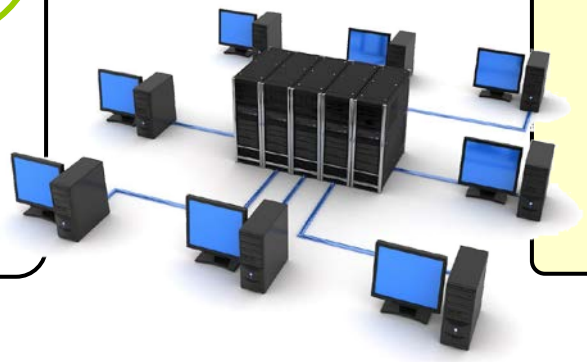
仕入先
コンピュータ
システム機器
メーカー

当　社

ネットワーク
ストレージ
ソフトウェア
システム構築
保守サポート

間接販売
販売パートナー

直販体制強化



お客様
企業
官公庁

事業拡大の源泉

◆環境エネルギー等成長分野への進出

① LED、電池などの取扱いを開始

⇒リンクラブス社、

インフィニット・パワー・ソリューションズ社

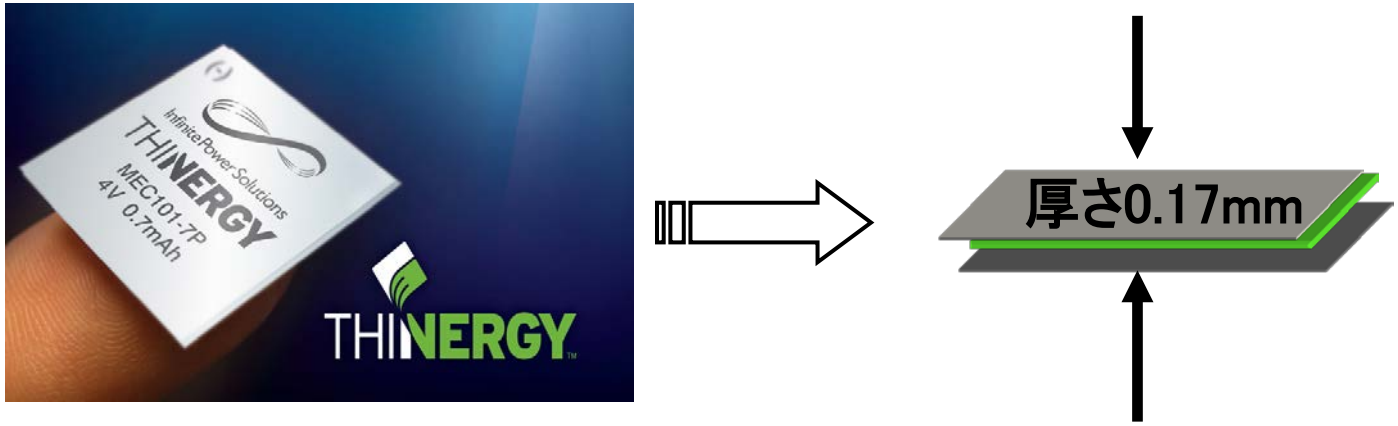
② 組み込み機器向け省電力製品の販売に注力

⇒インテル社製品の取扱いを開始

高機能リチウム電池

◆ 環境/省エネルギー関連商品の販売促進活動

インフィニット・パワー・ソリューションズ社



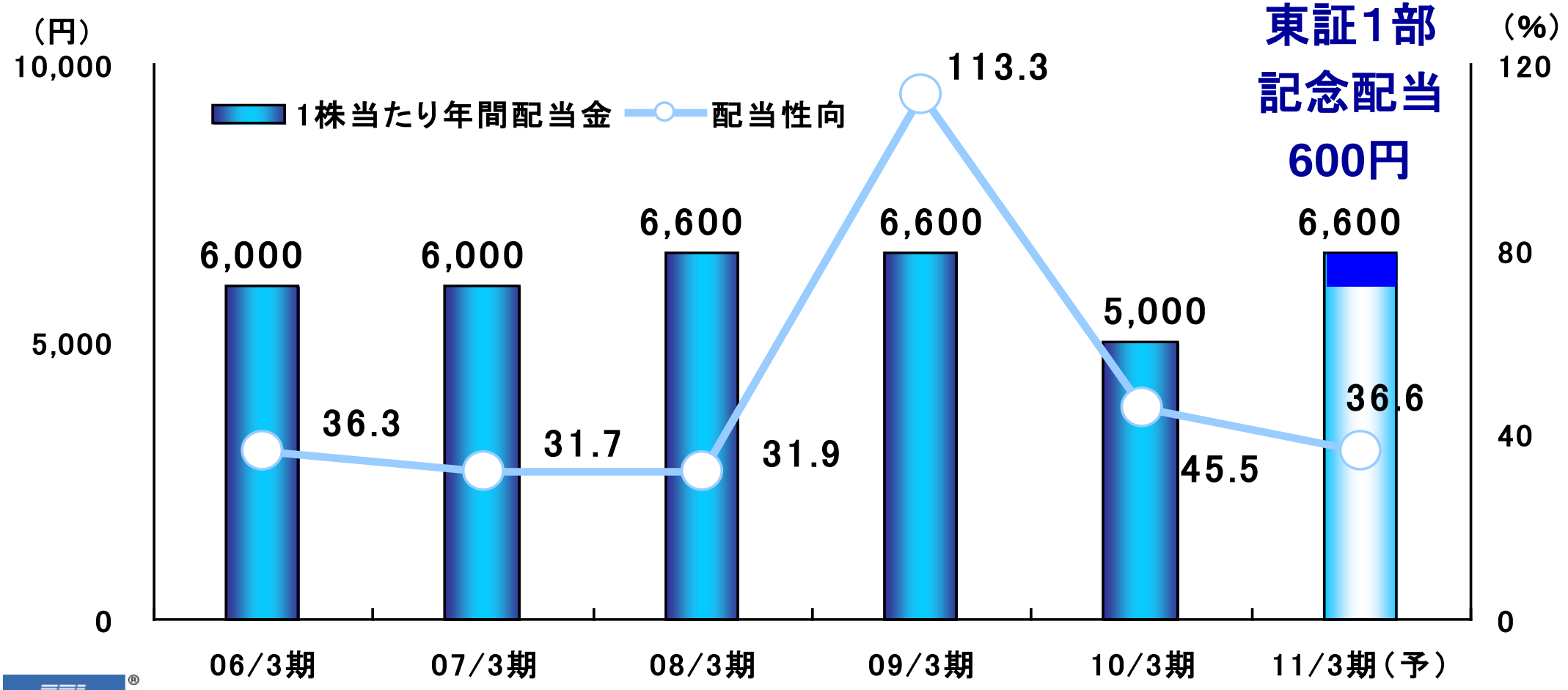
＜ 特 徴 ＞

- 省スペース： 超薄膜形成技術、厚さ0.17mm
- クリーンエネルギー： 有害物質なし、不発火
- 長寿命： 充電、放電10,000回、電荷保持10年

6. 株主還元

配 当 方 針

- ◆ 継続的かつ安定的な配当の実施
- ◆ 業績連動型として連結配当性向30%目安



おかげさまで 2010年12月24日
東証1部に上場いたしました。

今後も株主の皆様をはじめ
お客様 仕入先など
広く社会から信頼される
NO.1 技術商社を目指してまいります。

本日はご清聴ありがとうございました。

指 標

参考資料

	2006/3期	2007/3期	2008/3期	2009/3期	2010/3期
ROE	10.5%	10.7%	10.5%	2.9%	5.4%
自己資本比率	40.9%	42.9%	42.0%	52.6%	48.0%
EPS	16,525円	18,957円	20,689円	5,824円	11,000円
PER	17.4倍	11.1倍	8.5倍	17.2倍	13.4倍
PBR	1.7倍	1.1倍	0.9倍	0.5倍	0.7倍
従業員数	564名	739名	788名	825名	844名

注） PER、PBRは、各年度末の株価終値を使用し算出しています。

品目別仕入先名

補足資料

セグメント・品目		主な仕入先名
半導体事業	汎用ＩＣ	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、TI 社
	専用ＩＣ	カビウム・ネットワークス社、コネクサントシステムズ社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通セミコンダクター㈱、インターシル社、ピクセルワークス社、シリコンイメージ社、ビクシスシステムズ社、　サーリンク・セミコンダクター社、インレビアム
	カスタムＩＣ	富士通セミコンダクター㈱、ザイリンクス社、インレビアム
	マイクロプロセッサ	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通セミコンダクター㈱、TI 社
	メモリーＩＣ	IDT社、ラムトロンインターナショナル社、スパンション社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	単体電子部品	オン・セミコンダクター社
	電子部品他	コーセル㈱、インレビアム
コンピュータシステム事業	ネットワーク関連	エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
	ソフトウェア	マイクロソフト社、オラクル社、センセージ社
	ストレージ関連	ブロケード社、エミュレックス社

半導体事業　用語説明

補足資料

品　目	主な取扱商品	機　能
汎用IC	汎用リニアIC（アナログIC） 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるＩＣ
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用ＩＣ
カスタムIC	ASIC、PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有ＩＣ
マイクロプロセッサ	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
メモリーIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
単体電子部品	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品
電子部品他	ボード、電源、コネクタ	プリント配線基板上にＩＣ、電源、コネクタなどの 部品を実装した製品（ボード）

コンピュータシステム事業　用語説明

補足資料

ネットワーク関連機器		インターネット接続機器（負荷分散、セキュリティ） 企業向けネットワークシステム構築機器など
ソフトウェア		セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア 企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト社のソフトウェアなど
ストレージ関連機器		SAN（ストレージエリアネットワーク）スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など

資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがいまして、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。